

PERFAG 3D (Deutsch/Englisch)



Spezifikation für Mehrlagen-Leiterplatten, Specification for Multilayer PCBs, 232 Seiten, Format: DIN A4

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 77,57 €

83,00 €

Netto-Preis: 77,57 €

Enthaltene MwSt.: 5,43 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

PERFAG 3D gilt für die Spezifikation neuer Multilayer für den Leiterplattenhersteller. Die Spezifikation ist das Ergebnis einer freiwilligen Zusammenarbeit zwischen der PERFAG-Gesellschaft und den ihr angeschlossenen Leiterplattenproduzenten. Der Inhalt der Spezifikation ist eine Empfehlung, die freiwillig befolgt werden kann. Die PERFAG-Gesellschaft haftet auch nicht für Folgen, die aus Anwendung dieser Spezifikation entstehen.

Die Hauptkapitel PERFAG 3D im Überblick:

1. Basismaterial
2. Leiterbild
3. Durchmetallisierte Löcher
4. Nicht-metallisierte Bohrungen
5. Vergoldung von Kontakten
6. Lötstoppmasken
7. Decklagen
8. Komponentendruck
9. Kohleleitpastendruck (Carbondruck)
10. Abziehmasken
11. Oberflächenschutz
12. Oberflächenreinheit
13. Löten

- 14. Mechanische Bearbeitung
- 15. Abkürzungen
- 16. Vokabular

The main chapters PERFAG 4B at a glance:

- 1. Base Material
- 2. PCB Pattern
- 3. Plated-Through Holes
- 4. Nonplated-Through Holes
- 5. Gold for Contacts
- 6. Solder Masks
- 7. Coverlays
- 8. Component Notation
- 9. Carbon Ink Printing
- 10. Peelable Masks
- 11. Surface Protection
- 12. Cleanliness of Surface
- 13. Soldering
- 14. Machining
- 15. Abbreviations
- 16. Vocabulary